

SEMISOL

半導体後工程技術&ソリューション展



Smart Sensing 知能)の実装、環境発電に至るまで要素技術と応用を網羅的に紹介する。これまで電子機器・製造・実装や材料から信号処理、通信インターフェース、エッジAI(人工展の構成展として開催されてきたが、9回目の開催になる今回から独立した。同時開催の半導体後工程に特化したSEMISOLは初開催。半導体の設計・製造・実装や材料・装置・プロセス技術から、AI、モビリティ分野での応用展開まで半導体のバリエーション全体を網羅する技術専門展となっている。

最新センサー技術が一堂に会する(Smart Sensing2024)

18日開幕 東京ビッグサイト

最新のセンサー技術や半導体後工程技術などが集まる「Smart Sensing2025/SEMISOL2025 半導体後工程技術&ソリューション展」が18日から20日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟8ホールで開催され、63社・団体が出展する。JTBCコミュニケーションデザインが主催する。開場時間は10時~17時。来場は無料(事前登録制)。

P R

半導体プロセスDXー現場の高度化実現

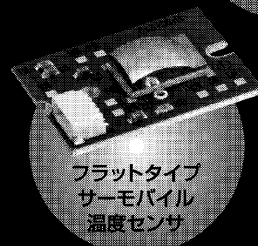
した製造業では生産性の最適化、人材不足など構造的な課題があり、センサー技術や半導体後工程技術の高度化、製造プロセスのデジタル変革(DX)への対応が不可欠となっている。2展を同時開催することで製造現場の高度化を支える最先端技術が一堂に会し、最適なソリューションを提案する。

会場では企画展示が行われる。「自立電源型IoTパビリオン」は振動発電デバイスや熱電モジュール、磁歪合金単結晶、IoTシステム構築など自立電源型IoT関連の製品・技術が集まる。また、最新のセンサー技術が集まり、出展各社によるピッチプレゼンテーションが行われる「次世代センサパビリオン」や、AIなどを活用した製造プロセスの最適化を図る情報技術プロセスシンフォマティクス「データとAIが導く未来ゾーン」もある。

映像投影、小さな光、大きな世界。
究極のコンパクト光源!



RGBレーザー光源
モジュール



フラットタイプ
サーモパイル
温度センサ

触れずに操作、
非接触センシング!



さわれない空中押しボタン

Smart Sensing2025 に出展します
2025.6.18 wed-6.20 fri 東京ビッグサイト 東8ホール



一歩先の未来をセンシング

光でつなぐ コーデンシ

空気、距離、
位置、回転等の
センシング!



自己気流方式
ほこりセンサ



回転検知
小型反射型
エンコーダ



測距センサ

社名: コーデンシ株式会社 連絡先: 0774-20-3559 住所: 〒611-0041 京都府宇治市槇島町十一の161

出展のご案内

120th
since 1905

SEMISOL2025

半導体後工程技術&ソリューション展

会期 2025.6.18(水)~20(金)

会場 東京ビッグサイト
東8ホール[G-2]

オクノのエレクトロニクス向け最新技術

奥野製薬工業は、半導体後工程向けの表面処理・めっき薬品として、TORYZAシリーズをリリースしました。
薬品だけでなく、装置に関してもあらゆるご要望にお応えします。
さらに、半導体パッケージ基板向けの最適なめっき添加剤を拡充。
オクノは、半導体産業の発展を支える表面処理・めっき薬品のリーディングカンパニーです。

妄想をカタチに。

TORYZA

www.okuno.co.jp

TOP 奥野製薬工業株式会社

Smart Sensing &

セミナー

会期中はセンサー、AI、IoT、半導体の最先端技術や業界動向に関する基調講演、特別講演など29の各種セミナーが開かれる。

基調講演は18日10時15分から「半導体3D集積とチップレットの研究開発動向」をテーマに横浜国立大学准教授で半導体量子集積エレクトロニクス研究センター副センター長の井上史大氏が登壇する。19日は13時半から経済産業省商務情報政策局情報産業課デバイス・半導体戦略室の清水英路室長が「日本政府の半導体産業支援戦略」を紹介する。

基調講演

特別講演は19日14時から「ASRAによるチップレット先端半導体の車載化について」を自動車用先端SOC技術研究組合の川原伸章事務理事が解説する。同日14時半からは元インテル代表取締役会長で半導体後工程自動化・標準化技術研究組合の鈴木国正理事長が「SATA S活動内容のご

特別講演

紹介」を講演する。
また、19日10時15分から「最新の世界半導体状況と、日本の未来への課題」をテーマに国際技術ジャーナリストでNews&Chips編集長とセミコンポータル編集長を務める津田建二氏が登壇する。同日16時20分からは大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装協働研究所長で特任教授の菅沼克昭氏が「エッジAI半導体後工程開拓に向けて」をテーマに講演する。

20日13時50分からは「AI・チップレット等先端半導体パッケージング構造設計と標準化の現状と課題」をテーマに電子情報技術産業協会(JEITA)半導体構造設計技術サブコミッティで大阪大学の吉田浩芳氏が講演する。
同日15時15分から「CES2025で見てきたAIの未来と日本への追い風」と題して日本政策投資銀行設備投資研究所の青木崇主任研究員が講演する。

コーデンス

コーデンスは光半導体技術基礎に、測距センサー、フォトインタラプター、光検知センサーの三つのセンサーをコア技術として確立。これらを基に、光学式エンコーダーやサーモパイル、ほりりセンサー、光源用発光ダイオード(LED)など、豊富な製品ラインアップを取りそろえている。

光センサーは種類が豊富なため、一般的にどのセンサーを使用すれば良いか判断が難しい。同社は光センサーの導入の相談も受け付けている。

奥野製薬工業

奥野製薬工業は半導体パッケージ基板のコア材として注目されるガラスに高い密着性を実現する「TORIZING(トライジング)プロセス」と、ガラス基板向けスルーホールフィリング硫酸銅めっき添加剤「トップルチナGCSシリーズ」をトータルプロセスとして紹介する。

このほか、半導体後工程向けブランド「TORYZA(トラライザ)」から無電解めっきプロセスおよびめっき装置、ウエハー向け硫酸銅めっきシリーズを紹介する。